



# 株式会社UKCホールディングス

## 2018年(平成30年)3月期 第3四半期決算説明資料

---

2018年2月9日



株式会社 UKCホールディングス

---



# 目次



## 2018年3月期 第3四半期決算(連結)概況

事業セグメント	4
2018年3月期 第3四半期 ハイライト	5
2018年3月期 第3四半期 半導体及び電子部品事業	6
2018年3月期 第3四半期 電子機器事業	7
2018年3月期 第3四半期 システム機器事業	8
2018年3月期 第3四半期 財政状態(バランスシート)	9

## 2018年3月期 通期連結業績

2018年3月期 通期連結業績/配当予想	11
----------------------	----





# 2018年3月期 第3四半期決算(連結)概況

# 事業セグメント

## システム機器事業

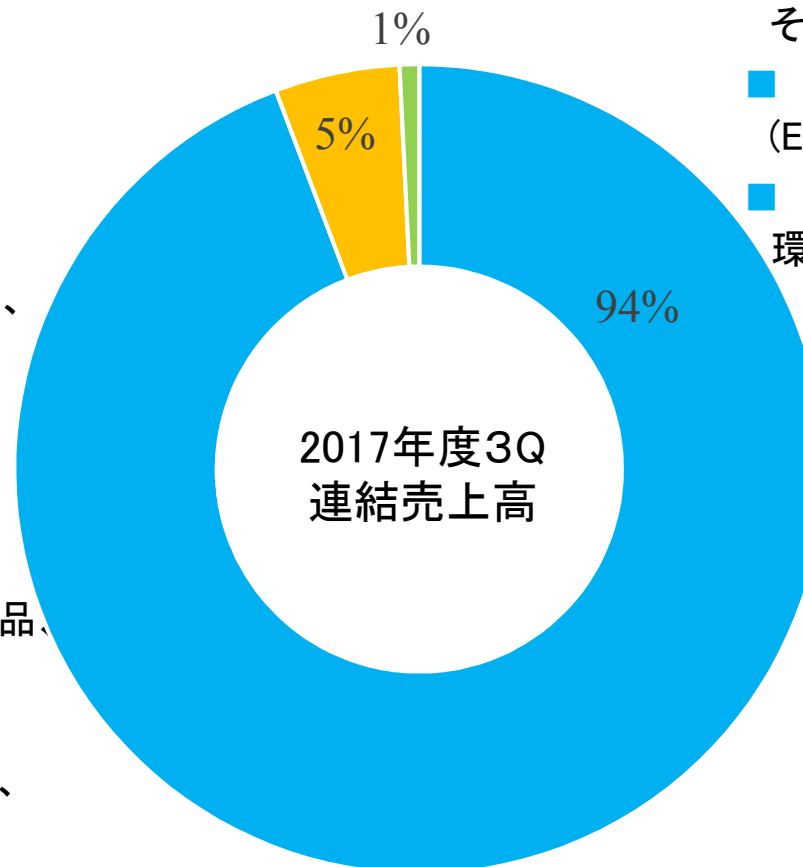
- システム機器  
非接触ICカード(FeliCa, NFC)R/Wモジュール、  
電子決済端末、出入管理端末
- 信頼性試験受託業務、環境物質分析受託業務

## 電子機器事業

- 電子機器  
各種VTR、カメラ、音響映像関連機器、  
ビデオプリンター
- 記録媒体  
磁気テープ、光ディスク、  
データ記録用ディスク
- 製品  
電子機器を組み合わせたシステム製品、  
セキュリティ関連製品
- その他  
電子機器の修理、AV機器のレンタル、  
教育用ソフトウェア

## 半導体及び電子部品事業

- 半導体  
イメージセンサー、メモリー、マイコン、  
システムLSI、パワー、その他半導体
- 電子部品  
液晶パネル、タッチパネル、バッテリー、  
光学ピックアップ、ACF、基板、複合部品、  
その他一般電子部品
- 電子機器受託製造サービス  
(Electronic Manufacturing Service)
- その他  
環境事業(LED照明、太陽光パネル等)



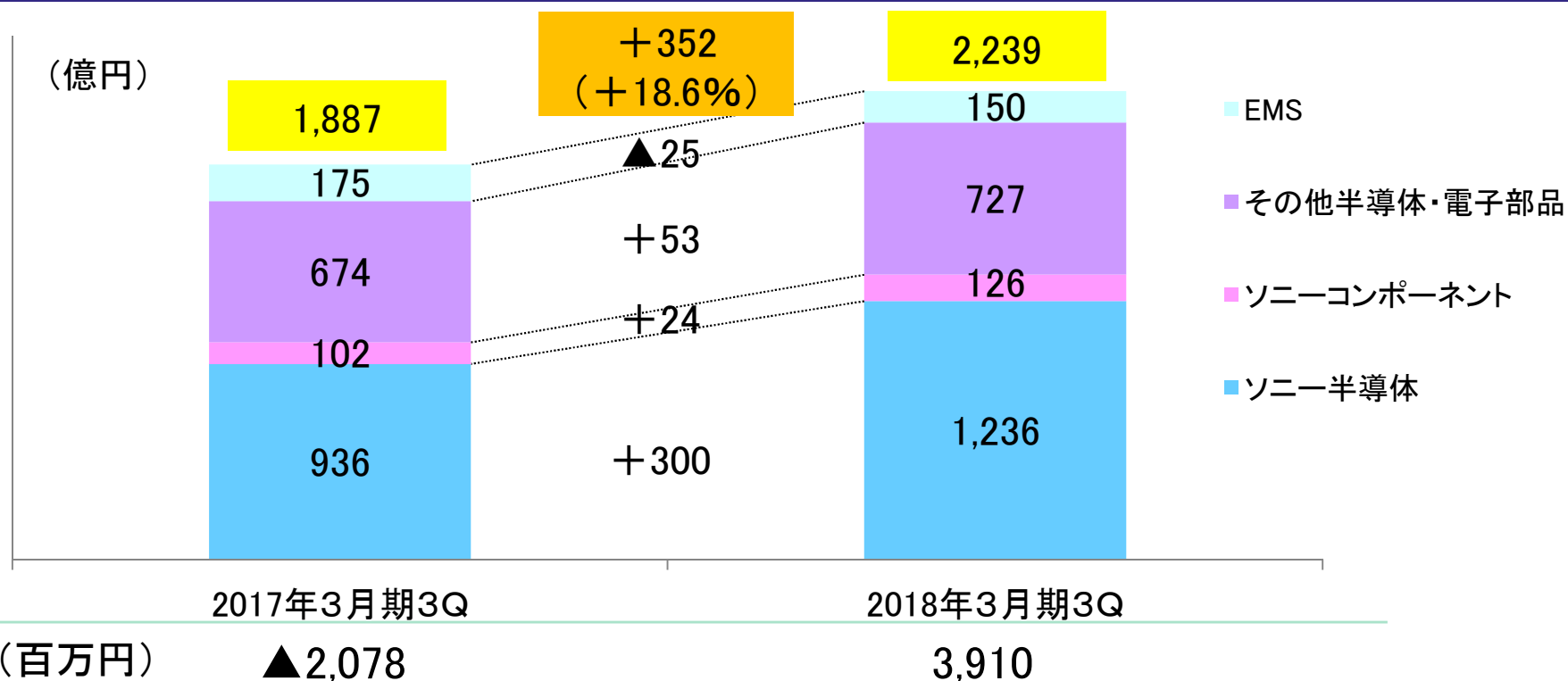
# 2018年3月期 第3四半期 ハイライト

(単位:百万円)	2017年3月期3Q累計※		2018年3月期3Q累計		前年同期比	
	金額	構成	金額	構成	増減金額	増減率
売上高	199,926	100.0%	236,164	100.0%	+36,237	+18.1%
売上総利益	10,963	5.5%	12,521	5.3%	+1,557	+14.2%
SGA	13,269	6.6%	8,660	3.7%	▲4,609	▲34.7%
営業利益	△ 2,306	△1.2%	3,860	1.6%	+6,166	-
経常利益	△ 2,493	△1.2%	3,589	1.5%	+6,082	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 3,263	△1.6%	2,378	1.0%	+5,641	-
EPS(円)	△ 207.89		151.53			

- 売上高: 前年同期比+362億円(+18.1%) 海外スマートフォン向け半導体売上が好調、国内向けは熊本地震の影響が剥離
- 売上総利益: 前年同期比+15.6億円(売上総利益率▲0.2%) 増収効果により増加。利益率はプロダクトミックス等により低下
- 営業利益: 前年同期比+61.7億円
  - ・SGA: 香港の貸倒引当金繰入損が剥離
  - ・貸倒引当金については、本社特定債権管理室、香港、シンガポールの連携により、全体の額を漸減させていく方針
  - 香港では、新しいマネジメントのもと、取引先の事業動向、財務状況の再精査を行い、当該事業のコントロールと売掛金等の回収を  
実行中。シンガポールでは、貸倒引当金を計上した取引は中止し、取引先からの返済入金をフォロー中
- 経常利益: 前年同期比+60.8億円
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 前年同期比+56.4億円
  - 香港における不適切会計関連費用(社内/第三者委員会調査、過年度決算訂正関連)の一部を過年度決算訂正関連費用として  
上期に特別損失に計上(約3.6億円)

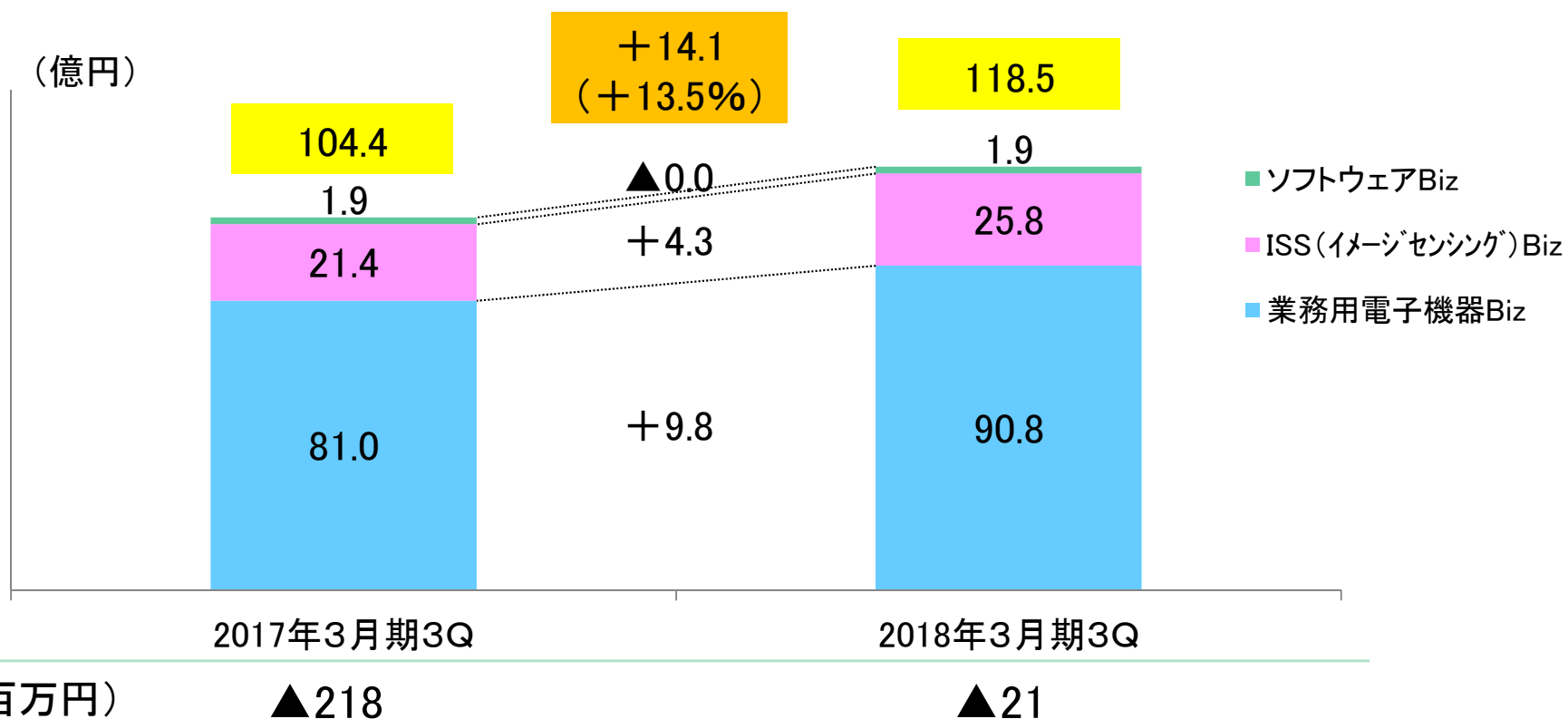
※7月31日に過年度決算訂正

# 2018年3月期 第3四半期 半導体及び電子部品事業



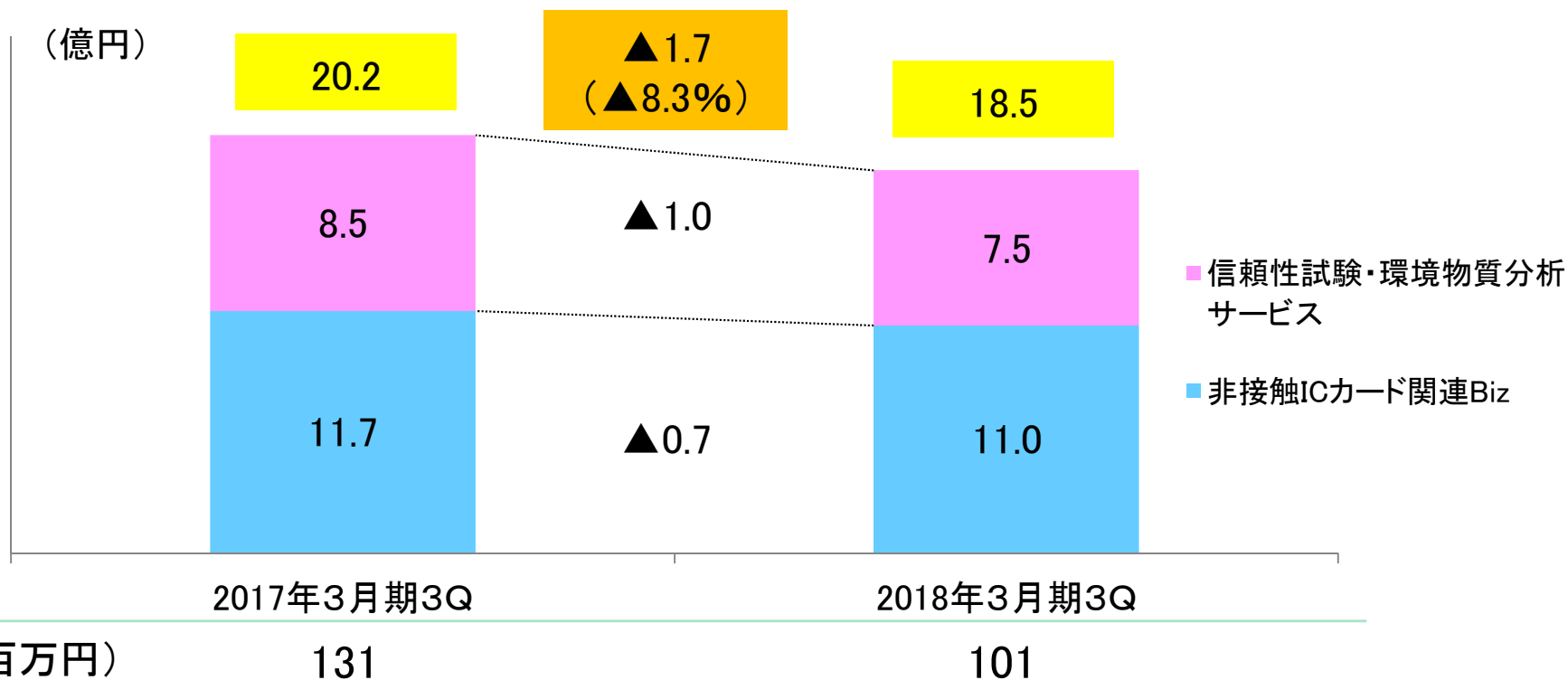
- ソニー半導体: 海外スマートフォン向けイメージセンサー好調に加えて、熊本地震の影響の剥離もあり増収
- その他半導体・電子部品: 電子材料、メモリー、車載向け中小型液晶等の売上が伸長
- EMS: ベトナム工場の稼働は好調も、中国スマートフォン向け需要の減速により、中国工場の稼働低下。  
事業全体の営業利益率は向上
- セグメント利益は増収効果に加え、前年同期の香港における貸倒引当金繰入額が剥離したことにより、黒字に転換し、利益水準は正常化

# 2018年3月期 第3四半期 電子機器事業



- 業務用電子機器ビジネス  
放送やメディカル分野における大型システム案件、4K関連需要活性化等により増収
- イメージセンシングビジネス  
装置メーカーの設備投資が好調なことにより増収
- 増収効果と利益率の向上により、セグメント損失は大きく改善

# 2018年3月期 第3四半期 システム機器事業



## ➤ 非接触ICカード関連ビジネス

電子マネーの用途の広がりは継続も、売上高は前年同期比減。4Qに入り、需要は回復傾向

## ➤ 半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス

車載向けの引き合いは増加しているものの、九州豪雨の影響もあり減収

## ➤ 利益率は向上したものの、減収によりセグメント利益は減少



# 2018年3月期 第3四半期 財政状態(バランスシート)

(単位:百万円)	17/3月末	17/12月末
現預金	20,076	16,372
売上債権 <sup>※1</sup>	76,333	69,780
棚卸資産	20,658	25,873
貸倒引当金	-11,950	-3,244
その他	11,307	6,370
<b>流動資産計</b>	<b>116,426</b>	<b>115,153</b>
有形・無形固定資産	3,505	3,370
貸倒引当金	-1,528	-10,167
その他	5,834	18,129
<b>固定資産計</b>	<b>7,811</b>	<b>11,332</b>
<b>総資産</b>	<b>124,237</b>	<b>126,485</b>
仕入債務	45,562	35,735
短期借入金	32,926	42,596
1年内返済長期借入金	1,325	2,028
その他	4,008	2,800
<b>流動負債計</b>	<b>83,823</b>	<b>83,159</b>
長期借入金	2,300	300
その他	960	2,108
<b>固定負債計</b>	<b>3,260</b>	<b>2,408</b>
<b>純資産</b>	<b>37,154</b>	<b>40,917</b>
<b>自己資本比率</b>	<b>29.6%</b>	<b>32.1%</b>
<b>BPS(円)</b>	<b>2,340.69</b>	<b>2,583.50</b>

※1 電子記録債権含む

	前期末比	主な増減要因
<b>総資産</b>	<b>+2,248</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現預金 ▲3,704百万円</li> <li>・売上債権<sup>※1</sup> ▲6,552百万円</li> <li>・たな卸資産 +5,215百万円</li> <li>・その他流動資産<sup>※2</sup> ▲4,937百万円</li> <li>・その他固定資産<sup>※3</sup> +12,294百万円</li> </ul>
<b>負債</b>	<b>▲1,514</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕入債務 ▲9,827百万円</li> <li>・短期借入金 +9,669百万円</li> <li>・1年内返済予定長期借入金 +702百万円</li> <li>・未払法人税等 ▲782百万円</li> <li>・長期借入金 ▲2,000百万円</li> </ul>
<b>純資産</b>	<b>+3,763</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・親会社株主に帰属する四半期純利益 2,378百万円</li> <li>・資本/利益剰余金からの配当 ▲941百万円</li> <li>・その他の包括利益 累計額の変動額 +2,374百万円</li> </ul>
<b>自己資本比率</b>	<b>+2.5%</b>	純資産の増加により、増加

※2 主に、香港の前渡金の回収による減少及び同前渡金の固定資産振り替えによる  
 ※3 主に、香港、シンガポールの売掛金、前渡金を固定資産に振り替えたこと、及び投資有価証券の増加による



# 2018年3月期 通期連結業績／配当予想

# 2018年3月期 通期連結業績／配当予想

(単位:百万円)	2017年3月期通期		2018年3月期第3四半期累計 (実績)			2018年3月期通期 (7月31日予想)		
	金額	構成	金額	構成	進捗率	金額	構成	前年比
売上高	273,752	100.0%	236,164	100.0%	78.7%	300,000	100.0%	+9.6%
売上総利益	16,012	5.8%	12,521	5.3%	71.6%	17,500	5.8%	+9.3%
SGA	22,615	8.3%	8,660	3.7%	72.2%	12,000	4.0%	▲46.9%
営業利益	△ 6,603	△2.4%	3,860	1.6%	70.2%	5,500	1.8%	-
経常利益	△ 7,385	△2.7%	3,589	1.5%	70.4%	5,100	1.7%	-
親会社株主に帰属 する当期純利益	△ 8,688	△3.2%	2,378	1.0%	70.0%	3,400	1.1%	-
EPS(円)	△ 553.49		151.53			216.60		

- 第3四半期累計連結業績は、海外スマートフォン向け半導体売上が好調に推移したことから、売上高は進捗率79%弱。利益面では70%程度の進捗率
- 通期業績については、7月31日公表の予想を据え置く
- 10月20日に公表した通り、サムスングループ向けのソニー半導体販売は12月末に終了  
他事業の拡大や事業の高付加価値化により、来期業績への影響の軽減、最小化を図る
- 12月22日に東証に改善報告書を提出。コーポレートガバナンス、コンプライアンス強化施策を推進中  
その一環として、監査等委員会設置会社への移行方針及び「指名・報酬委員会」の設置を1月30日に決議
- 配当は、計画通り年間60円の予定(第2四半期末実績30円、期末予定30円)



株式会社 UKCホールディングス

〈お問い合わせ先〉

経営企画部門 大澤, 中川

Mail to: [ir@ukcgroup.com](mailto:ir@ukcgroup.com)

本プレゼンテーション資料中のデータや将来予測は、資料作成時点における当社の判断や入手可能なデータに基づくもので、今後様々な要因によって変化することがあり、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。